

### 2-1-2-25 FPC 表面汚れ／ FPC 表面的玷污／ Dirty FPC surface

【特徴】 F P C カバーレイの表面に汚れ跡が残っている状態の欠陥

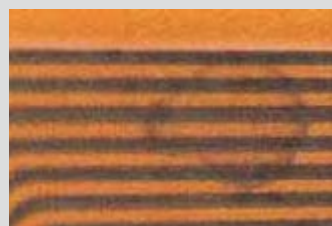
【特征】 在 FPC 覆盖层表面留下玷污痕迹的缺陷。

【Characteristics】 Stain mark left on an FPC coverlay

【原因・判断ポイント・発生工程】 最終検査工程などで何らかの薬液を誤って適下させた跡が残って出来たもの（出荷検査工程など）

【原因、判断要点、发生工序】 在最后检查工序等，因为错误滴下某种药液，留下痕迹所引起的（出厂检查工序等）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
A mark of a drop of some kind of chemical carelessly dropped in the final inspection process, etc. (Delivery inspection, etc.)



【コメント】  
FPC  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
FPC  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
FPC  
Magnification: ×

### 2-1-2-26 SR 下地汚れ／ SR 基底玷污／ Dirty base material under solder resist

【特徴】 S R 印刷前の銅箔面や基板樹脂面に汚れ跡が残っている状態の欠陥

【特征】 在 SR 印刷前，銅箔面或者樹脂面留下玷污痕迹的缺陷。

【Characteristics】 The copper foil surface or the laminate surface of a board before solder resist application has a soil mark.

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R 印刷前の整面不良により汚れが除去できなかつたり、整面時の薬液残渣があつたり、印刷前の板面に誤って接触したことによる汚れが残って出来たもの（S R 印刷前工程）

【原因、判断要点、发生工序】 由于 SR 印刷前的表面处理不良，不能铲除玷污，或者表面处理时有药液残渣，抑或印刷前板面接触而玷污所造成的（SR 印刷前工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】  
Surface abrasion before solder resist application fails to remove soils, a chemical is left on the surface after surface cleaning or a board to be printed is contaminated by a careless contact with something to cause the defect. (Before solder resist application process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 × 75  
【注釋】  
显微镜倍率 × 75  
【Comments】  
Magnification: ×75



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×  
【注釋】  
显微镜倍率 ×  
【Comments】  
Magnification: ×